



天津普林电路股份有限公司

行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的全部内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.com.cn>)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力。

第一节 重大事项提示

1、本次发行前公司总股本146,679,815股，本次拟发行5,000万股，发行后总股本196,679,815股。本公司控股股东天津市中环电子信息集团有限公司及第二大股东天津国际投资有限公司承诺，自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

2、主要股东持股情况
(1)本公司持股量居前10名股东和持股5%以上股东情况
本次发行之前，本公司共有5名股东，其持股情况如下：

序号	股东名称	股份数	比例
1	天津市中环电子信息集团有限公司(SLS)	52,335,358	35.68%
2	天津国际投资有限公司(SLS)	50,091,157	34.15%
3	普林电子有限公司	41,319,704	28.17%
4	天津经发投资有限公司	1,466,798	1%
5	天津保税区投资有限公司	1,466,798	1%
	小计	146,679,815	100%

保荐人(主承销商): CITIC 中信证券股份有限公司

普通股(A股)5,000万股，发行前后股本结构如下：

股东名称	股份数	本次A股发行前		本次A股发行后	
		股份数(股)	股权比例	股份数(股)	股权比例
天津中环电子信息集团有限公司	A股	52,335,358	35.68%	52,335,358	26.61%
天津国际投资有限公司	A股	50,091,157	34.15%	50,091,157	25.47%
普林电子有限公司	A股	41,319,704	28.17%	41,319,704	21.01%
天津经发投资有限公司	A股	1,466,798	1%	1,466,798	0.75%
天津保税区投资有限公司	A股	1,466,798	1%	1,466,798	0.75%
A股投资者	小计			50,000,000	25.42%
	合计	146,679,815	100%	196,679,815	100%

注:SLS为国有法人(state-owned legal-person shareholder)的缩写

(2)公司前10名自然人股东

本次发行前，本公司没有自然人股东。

3、发行人的发起人和主要股东之间的关联关系

天津保税区投资有限公司持有天津经发投资有限公司14.286%的权益，除之外公司的其他股东不存在关联关系。

四、发行人的业务情况

1、发行人的主营业务

本公司的主营业务为生产、销售双面和多层印刷电路板。

2、产品销售方式和渠道

本公司的国内销售主要是面对直接用户销售，按照客户订单进行生产，实现销售。本公司的国外销售有大约60%通过代理商进行，大约40%直接面对用户销售。直接用户销售的模式与国内基本相同，主要是按照订单进行生产和销售。通过代理商进行销售时，本公司与代理商签订销售协议，并与代理商进行结算，本公司只承担产品质量责任，除此之外的其他销售风险由代理商承担。

3、主要原材料

覆铜板、铜箔、半固化片、化学药水、阳极铜镍、干膜、油墨等是本公司生产所需的主要原材料。

4、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

近年来，我国印刷电路板行业的增长较快，根据中国印制电路行业协会的统计，2004年和2005年，全行业需求增长分别为35.8%和32.9%。2005年，以销售额计算，本公司的市场份额占约0.29%。2006年6月份，普林二厂开始试运行，8月份正式投入生产，在2006年底已形成多层板产能1万平米/月。2007年上半年普林二厂一期投资将全部完成，将再形成多层板产能1万平米/月。届时本公司总产能将达到48万平米/年，较2005年增长一倍，公司的市场份额将有一定增长。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

1、商标：公司拥有一项商标，已在国家工商行政管理局商标局注册。

2、土地使用权：本公司拥有土地使用权三处，合计面积约6.64万平方米，均已取得土地使用权证书。

3、房屋建筑物

本公司拥有已取得房产证的房产5处，建筑面积合计6,919.18平方米。

六、关于同业竞争和关联交易

(一)同业竞争

本公司主营双面和多层印刷电路板的生产和销售。本公司的控股股东中环集团主要从事电子仪表产品的研制、开发及销售；经济信息咨询服务等，与本公司不存在同业竞争。

(二)关联交易

1、经常性关联交易

本公司向天津电路板厂租赁房产，租赁房产面积共7,123平方米。2004、2005年及2006年租赁费用分别为131.65万元、176.24万元和174万元。

2、偶发性关联交易

(1)本公司前控股股东于2002年6月14日与天津国投签订《贷款合同》(金字200203号)，借款金额670万美元，借款期限为2002年6月14日至2010年6月20日。2006年1月24日，本公司与天津国投签订《关于金字200203号合同的补充协议》，约定于2005年12月20日将金字200203号合同中约定的贷款本金按照美元对人民币1:8.08转换为人民币，即贷款本金为人民币5,413.60万元。中环集团为本公司与天津国投签订的金字200203号《贷款合同》提供担保。

经本公司2006年12月1日第一届董事会第七次会议及2006年12月19日

2006年第三次临时股东大会批准，本公司于2006年12月21日归还了上述借款

2,000万元，于2006年12月31日归还上述借款3笔，413.6万元，并于2006年12月20

日与天津国际投资有限公司、上海浦东发展银行天津分行三方签署了委托贷款合同，合同编号为J70320062800。通过上海浦东发展银行天津分行从天津国际投资有限公司借款54,136,000.00元，贷款期限为2006年12月29日至2005年12月28日，贷款利率为6.12%，以上述贷款于2006年12月31日由银行划入。

经本公司200